

## 产品描述

- 该产品为上行 1270/1330nm 波长/工作速率 25G、下行 1330/1270nm 工作速率 25G 的点对点 BOSA 组件。发端采用 DFB 激光器，收端采用 PIN-TIA 二极管。
- 芯片信息：
  - LD: 1270nm/1330nm 25G DFB 5PIN
  - PT: 25G PIN-TIA
- 产品结构备注：LC/PC 插芯套组件，机加工/粉末件结构，接收端腔体结构，带隔离器。

## 产品应用

- 远程通讯
- 点对点通讯

## 25G LC BIDI BOSA(10km)

### 产品特点

- 采用激光焊接方案
- 点对点应用
- 高光学隔离
- 工作温度：-40°C~85°C
- 插拔式 SC BOSA

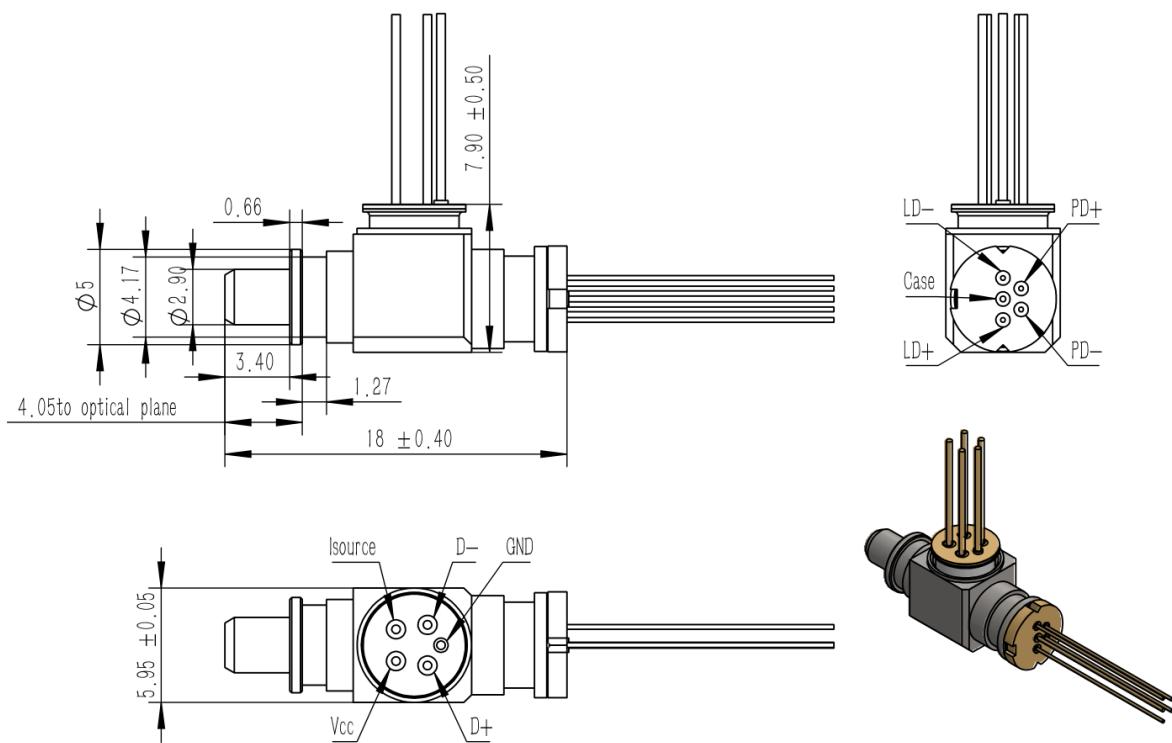
### 产品标准

- 符合 Telcordia GR - 468 可靠性测试标准
- 符合 RoHS 6 项 标准
- 符合 ROHS(对有害物质的限制)标准
- 符合 GR - 326 连接器合格标准
-



		4dB,BER≤10-12,CW				
Optical Return Loss	ORL	$\lambda=1270/1330\text{nm}$	--	---	-20	dB
Optical Crosstalk	XTALK	1270nm/1310nm 1310nm/1270nm		---	-40	dB

#### 4. Dimension Outline



注：单位，mm，未注公差±0.05mm。